公司代码:688508　　公司简称:芯朋微

无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)。公司总股本 131,310,346 股,扣除回购专用证券账户中股份数 2,258,565 股,以此计算合计拟派发现金红利 58,073,301.45 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.17%。如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯朋微	688508	

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易慧敏	孙朝霞
联系地址	无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦	无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦
电话	(0510)85217718	(0510)85217718
传真	(0510)85217728	(0510)85217728
电子信箱	ir@chipown.com.cn	ir@chipown.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向,专注于为客户提供电源和电机系统芯片及解决方案。公司主要产品为高可靠性电源管理芯片、功率器件以及各类驱动产品,主要品类包括 AC-DC 电源产品线、DC-DC 电源产品线、Digital PMIC 电源产品线、驱动产品线、功率器件产品线和功率模块产品线等六大类,目前有效的产品型号超 2,000 款,全面覆盖服务器电源、通信、光伏 / 储能 / 充电桩、智能电网、工业电机、智能家电、智能终端的充电器适配器等众多领域。

公司主要产品六大产品线如下:

2.2 主要经营模式

公司是集成电路产业链中的集成电路设计公司,采用 Fablite(轻资产制造)模式,持续专注于产品的设计研发和市场开拓,生产主要采用委托外包形式,同时充分利用公司较为充沛的现金,逐步加大对上游多家晶圆厂和封测厂的投资入股和产线设备深度合作。以轻资产逐步介入上游制造战略资源、侧重产品研发和市场销售的 Fablite(轻资产制造)经营模式非常有利于提高公司核心竞争力和整体营运效率。

具体模式可分为:

(一)研发模式

公司坚持“数一数二”的研发目标,“以创新为驱动,以市场需求为导向”策略,紧跟市场需求变化趋势,基于自主研发的高低压集成技术平台,不断进行迭代更新,增加产品品类,拓展应用领域,从而实现公司收入的增长。公司产品依托服务器、EDA、AI 模型、芯片验证测试平台、系统应用平台及自有的可靠性与失效分析 CNAS 实验室平台等复杂软硬件环境进行研发,研发过程可分为立项、设计、工程批试产和定型等环节。

(二)营运模式

Fablite(轻资产制造)模式下,公司生产模式以委外加工为主,产品主要的生产环节包括晶圆制造、封装、测试等均通过委外加工的方式完成。公司将自主研发设计的集成电路布图交付晶圆制造商进行晶圆生产,然后再交由封装测试厂商完成封装、测试,从而完成芯片生产。为保证公司产品质量,公司对每一环节均执行严格的质量控制,按照产品规格及公司研发标准要求外包生产商,制定切实有效的质量流程及管理制度。同时,通过投资入股和共建设备专有产线等模式与上游晶圆厂、封测厂深度战略合作,加大对晶圆工艺及封测制程中差异化价值技术的研发和量产应用。

(三)销售模式

公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式,目前主要通过经销商销售产品。在经销模式下,公司向经销商进行买断式的销售,同时公司会对经销商进行发货信息穿透、期末备货管控、年度审计;在直销模式下,公司直接将产品销售给终端客户。

2.3 所处行业情况

(1). 行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。

集成电路作为信息产业的基础和核心,是国民经济和社会发展的战略性产业,在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。集成电路行业作为快速发展的高科技行业,各种新技术、新产品不断更新,一方面产生了巨大的市场机遇,另一方面也导致市场变化较快。根据摩尔定律,当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔 18-24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,需要公司不断开发出适销对路的新产品以求跟上市场的需求。集成电路设计行业技术不断革新,持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。

中国集成电路行业起始于上世纪末,自 2000 年颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来,国家相继颁布多项政策大力扶持和推动集成电路行业发展。在市场需求拉动和政策支持下,中国集成电路产业虽起步较晚,但产业规模迅速增长,自给率也在不断提高。

根据美国半导体行业协会(SIA)发布的报告,2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元,同比增长 25.6%,创历史新纪录,2026 年有望进一步攀升至约 1 万亿美元。中国市场同样表现强劲。根据 SIA 数据,2025 年中国半导体销售额首次突破 2,000 亿美元,超过 2100 亿美元,同比增速超过 15%,占全球总额约三成。海关总署数据显示,2025 年中国集成电路出口总额达 14,442 亿元人民币,同比增长超 27%,出口单价首次突破 4 元 / 个,双双创下历史新高。与此同时,出口额与进口额的比值接近 0.48 倍,连续五年递增,充分印证国产半导体自给率不断提升。

2025 年,中国集成电路产业延续高速发展态势,在政策扶持、技术攻坚与市场需求的多重驱动下,逐渐实现从“单点突破”到“链式协同”的战略跃迁,具体表现为:细分龙头芯片企业与半导体下游应用端协作深度和广度上取得显著进步,国产半导体产业链逐步形成“设计 - 制造 - 封测”深度资源协同体系,下游市场和上游资源不断向芯用微等细分龙头规模企业汇聚,利好中国半导体产业的健康快速发展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体分为集成电路 IC 和分立器件,其中,集成电路 IC 包括模拟 IC、微处理器 IC、通用逻辑 IC 和存储 IC,分立器件包括光电子、传感器和分立器件。公司的产品主要包括 PMIC、AC-DC、DC-DC、Gate Driver 及配套的功率器件,属于模拟 IC 里的功率 IC(包含“电源管理 IC”、“驱动 IC”)和分立器件中的功率器件(含功率模块)。

公司是国家规划布局内重点集成电路设计企业和高新技术企业,是国内少有的完整具备高低压电源芯片、高低压驱动芯片、功率器件、功率模块、电源电机功率系统芯片及解决方案的公司,尤其是高压 ACDC 产品具备国际一流水准,根据国际知名市场研究机构 Omdia 于 2024 年发布的行业统计报告中,芯朋微位列“AC-DC integrated switching regulators”产品大类的全球第二名。

公司获得了包括“国家技术发明二等奖”、“江苏省科学技术一等奖”在内的多项权威奖项,参与了《家用电器待机功率测量方法》、《智能家用电器通用技术要求》和《智能家用电器系统架构和参考模型》等多项国家标准的起草制定,在国内率先开发成功并量产了 700V 单片高低压集成开关电源芯片、1500V/1700V 高低压集成开关电源芯片、数字图腾柱无桥 PFC 芯片、零瓦待机高低压集成开关电源芯片、1200V 半桥驱动芯片、200V SOI MOS/LIGBT 集成驱动芯片、100V CMOS/LDMOS 集成驱动芯片等产品,拥有 129 项已授权的国内和国际专利、200 项集成电路布图登记。公司的“高低压集成”核心技术在业内一直享有较高的知名度。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①家用电器领域

家电市场主要包括各类生活家电、厨房家电、健康护理家电、白电(冰箱 / 空调 / 洗衣机)、黑电(电视 / 智慧显示屏)等。功率芯片主要负责将源电压和电流转换为可由智能模块如微处理器、传感器等负载使用的电源,因此,搭载智能模块的生活家电、厨房家电、健康护理家电均需要使用多颗不同类型的功率芯片。无论是小家电还是白电,配备网络交互、智能语音控制功能以实现更便捷的操控体验,将各类传感器集成实现更智能运转控制,这使得家电智能化成为不可阻挡的行业发展趋势。

2025 年 6 月,市场监管总局(国家标准委)发布新版 GB 12021.2 — 2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》国家标准,将于 2026 年 6 月 1 日起正式实施。修订后的电冰箱能效国家标准提高了能效等级指标和耗电量门槛要求。以 500L 对开门冰箱为例,现行标准中一级能效综合耗电要求为 0.92 度 / 天,新标准将降至 0.55 度 / 天,电耗下降约 40%。能效标准的提升,待机低功耗的 AC-DC 芯片及 BLDC 驱动芯片渗透率有望继续大幅提升。

2024 年 3 月,国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,指出,“以提升便利性为核心,畅通家电更新消费链条。支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动,开设线上线下家电以旧换新专区,对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠;鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴;加快实施家电售后服务提升行动”。2025 年政策进一步扩大补贴范围,家电品类由 8 类增至 12 类,单件最高可享销售价格 20% 的补贴。2025 年 1-11 月,全国家电以旧换新总量超 12,844 万台。“以旧换新”政策的出台直接推动家电行业加速生产。

根据中商产业研究院数据,从出口量来看,2025 年 12 月中国家用电器出口量 37,011 万台,同比增长持平;1-12 月中国家用电器出口量 445,294.7 万台,同比下降 0.6%。从金额来看,2025 年 12 月中国家用电器出口金额 7,813 百万美元,同比下降 0.1%;1-12 月中国家用电器出口金额 96,232.6 百万美元,同比下降 3.9%。出口总量的下滑并非海外市场就此一蹶不振,就整体规模而言,2025 年度的出口总量依然是历史第二高位,仅次于 2024 年度的 9,600 万台。

② 标准电源领域

标准电源主要是指各类电子设备的外置式、交流电输入、直流输出规格的电源模块。通常称为外置电源适配器、充电器。具体应用品类包括各类手机 / 可穿戴智能设备充电器、无人机充电器、光纤 MODEM/ 路由器 / 机顶盒 / 笔记本适配器、电动自行车 / 电动工具充电器、中大功率照明适配器、Qi 无线充电器等。

随着物联网设备、智能终端、无线网络等数码产品的普及,标准电源的应用场景不断增加;尤其随着快充技术不断发展,输出功率持续增大,电路拓扑架构创新涌现,宽禁带器件进一步提升功率密度,带给终端用户的体验更佳,使得快充技术已从手机逐步覆盖至平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、IoT 设备等多个领域,场景多元化叠加技术进步,带动标准电源类芯片需求强劲增长。

2025 年 1 月,国家标准 GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》发布,并将于 2027 年 2 月 1 日起正式实施。该标准对各类电源的能效提出了更全面、更严格的要求,旨在推动行业节能降耗和技术升级。新国标的强制实施,将推动氮化镓等第三代半导体功率器件的广泛应用,加速高效电源芯片的普及。

③ 工控功率领域

工控功率类市场主要包括光储充、服务器、智能电网、通信基站、工业电机设备等。随着经济社会的发展,全球能源需求持续增长,能源资源和环境问题日益突出,加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。国家能源局数据,2025 年全国可再生能源发电新增装机 4.52 亿千瓦,同比增长 21%,占全国电力新增装机的 83%。其中,水电新增 1,215 万千瓦,风电新增 1.2 亿千瓦,太阳能发电新增 3.18 亿千瓦,生物质发电新增 151 万千瓦。新能源发电的普及直接推动适配逆变器、储能装备的芯片及模块的需求量大幅提升。

2023 年,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,指出:要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉。加快通信网络与千兆光网协同建设,深入推进 IPv6 规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。服务器作为数据中心最核心的基础设施,《规划》的出台将加速服务器芯片的国产替代进程。

随着生成式 AI(如大模型训练、多模态内容生成)的规模化应用,算力需求呈指数级增长,与之配套的服务器电源芯片市场“井喷式”发展。根据 Valuates Reports 的统计数据,2024 年全球 AI 服务器电源市场规模为 28.46 亿美元,预计到 2031 年将增长至 608.10 亿美元,2025 - 2031 年复合增长率高达 45%。

④ 新能源车领域

中国汽车工业协会数据,2025 年度我国汽车产销量分别达 3,453.1 万辆和 3,440 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%。其中,新能源汽车产销量分别达 1,662.6 万辆和 1,649 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%。传统燃油车升级至新能源汽车,直接推动功率半导体(电源管理 IC、驱动 IC 和功率器件)价值量大幅提升,如,中混动(MHEV)车型的功率半导体成本大约为 150 美元;强混动(FHEV)车型的功率半导体成本则约为 470 美元;插混(PHEV)和纯电动(BEV)车型的功率半导体成本则高达约 600 美元;新能源汽车的普及为功率半导体带来千亿级增量市场。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,308,444,929.69	2,949,377,669.30	12.17	2,778,728,855.83
归属于上市公司股东的净资产	2,725,701,755.29	2,492,243,636.93	9.37	2,488,887,730.69
营业收入	1,142,720,469.02	964,595,737.94	18.47	780,377,821.41
利润总额	185,087,315.45	101,838,026.55	81.75	43,274,725.10
归属于上市公司股东的净利润	186,300,408.08	111,330,093.45	67.34	59,478,039.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,873,849.10	73,122,045.32	-23.59	33,560,090.40
经营活动产生的现金流量净额	1,844,969.89	40,578,195.63	-95.45	-6,136,360.90
加权平均净资产收益率(%)	7.17	4.52	增加 2.65 个百分点	3.28
基本每股收益(元/股)	1.45	0.87	66.67	0.50
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.87	66.67	0.50
研发投入占营业收入的比例(%)	22.60	23.44	减少 0.84 个百分点	27.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	301,412,185.19	334,611,557.41	241,328,578.63	265,368,147.79
归属于上市公司股东的净利润	41,072,939.04	49,420,529.60	87,346,016.17	8,460,923.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,603,255.29	33,838,363.41	3,610,456.11	-16,178,225.71
经营活动产生的现金流量净额	18,620,752.48	-11,344,503.22	23,273,672.28	-28,704,951.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,305
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,811
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张立新	-2,589,396	31,711,604	24.15	0	无	0	境内自然人
易扬波	150,000	4,834,000	3.68	0	无	0	境内自然人
李志宏	0	2,617,776	1.99	0	无	0	境内自然人
陈健	416,656	1,856,514	1.41	0	无	0	境内自然人
薛伟明	0	1,597,000	1.22	0	无	0	境内自然人
王霞	335,300	1,365,300	1.04	0	无	0	境内自然人
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有学1号私募证券投资基金	-220,000	1,307,327	1.00	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-2,626,200	1,114,401	0.85	0	无	0	国有法人
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有学3号私募证券投资基金	-130,000	1,108,465	0.84	0	无	0	其他
华林创新投资有限公司	-435,000	975,000	0.74	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

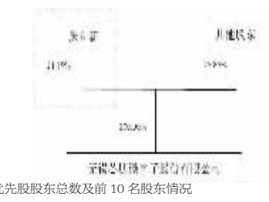
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 1,142,720,469.02 元,实现归属于母公司所有者的净利润 186,300,408.08 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产为 3,308,444,929.69 元,归属于母公司所有者的净资产为 2,725,701,755.29 元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688508　证券简称:芯朋微　公告编号:2026-018

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对相关资产计提了相应的减值准备。2025 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失 6,746.18 万元,具体情况如下表:

项目		金额(万元)
信用减值损失	应收账款	-124.88
	其他应收款	25.17
	应收票据	-0.49
资产减值损失	存货跌价损失	-6,645.98
合计		-6,746.18

注:损失以“-”号列示。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。经测算,2025 年度需计提信用减值损失金额共计 100.20 万元。

(二)资产减值损失

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。经测算,2025 年度需计提资产减值损失金额共计 6,645.98 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,对公司 2025 年度合并利润总额影响 6,746.18 万元(合并利润总额未计算所得税影响),本次计提减值准备事项是基于谨慎性原则,客观体现了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次 2025 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:688508　证券简称:芯朋微　公告编号:2026-009

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于募集资金投资项目实施方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下称“芯朋微”或“公司”)2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》,同意公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”及“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”的实施方式进行变更,部分测试产线由自建变为自建,并对内部投资结构进行调整。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2138 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)17,904,986 股,每股面值 1 元,发行价格为 54.11 元 / 股,募集资金总额为人民币 968,838,792.46 元,扣除发行费用 8,955,125.23 元(不含税),本公司实际募集资金净额为人民币 959,883,667.23 元。上述募集资金到位情况由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公 W[2023]B069 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目情况

根据公司披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》及公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-010)。

公司向特定对象发行股票募投项目截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	33,928.29	33,928.29	12,421.53
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	42,794.66	41,899.15	15,853.75
3	苏州研发中心项目	20,160.93	20,160.93	15,112.96
合计		96,883.88	95,988.37	43,388.24

三、本次募集资金投资项目实施方式变更的原因及情况

(一)募集资金投资项目实施方式变更的原因

为提升产品的可靠性、良率与供货能力,稳定公司的大规模交付供给,公司拟将原定通过共建方式建设募投项目“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发”测试产线变更为通过自建方式建设;同时,基于土地集约原则,将“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”中配套建设工业级半导体测试中心一并纳入本次产线建设,建成后公司自建测试产线将以车规级产品的可靠性试验、圆片测试、成品测试为主,工业级数字电源产品测试为辅。因此,募投项目中原规划用于软硬件设备及 IP 购置的部分资金将调整用于自建测试产线的场地购置、装修费用,未来自建测试产线如存在软硬件设备及 IP 购置资金缺口,公司将以自有资金予以补足,确保测试产线的顺利投产。

(二)调整募投项目内部投资结构的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	金额增减情况
新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	1	场地购置、装修费用	1,725.00	12,000.00	10,275.00
	2	软硬件设备及 IP 购置	15,321.63	5,046.63	-10,275.00
	3	研发费用	16,881.66	16,881.66	0
	4	基本预备费	0	0	0
	5	铺底流动资金	0	0	0
	合计	项目总投资	33,928.29	33,928.29	0
工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	1	场地购置、装修费用	1,900.00	6,500.00	4,600.00
	2	软硬件设备及 IP 购置	20,428.00	15,828.00	-4,600.00
	3	研发费用	19,571.15	19,571.15	0
	4	基本预备费	0	0	0
	5	铺底流动资金	0	0	0
	合计	项目总投资	41,899.15	41,899.15	0

四、募集资金投资项目实施方式变更对公司的影响

本次募集资金投资项目实施方式变更是公司根据行业发展、实际经营需要及项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关要求。

五、公司履行的审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》,同意公司在募投项目实施主体及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目的内部投资结构,将部分测试产线由共建变更为自建。该事项尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次募集资金投资项目实施方式变更的事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目实施方式变更事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次募集资金投资项目实施方式变更事项无异议。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:688508　证券简称:芯朋微　公告编号:2026-011

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人:无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司(以下简称“苏州博创”)员工,不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联方;

本次担保金额:为苏州博创员工租房提供担保金额不超过 200 万元;

本次担保是否有反担保:否;

对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况;

本次提供担保事项经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持苏州博创员工租赁公租房,公司全资子公司苏州博创拟为其员工租赁公租房提供担保,担保合计金额不超过人民币 200 万元,实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。为提高公司决策效率,授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务,授权期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时,公司授权苏州博创作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司全资子公司苏州博创拟为签订正式劳动合同的员工提供担保,前述员工不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象,根据员工申请,经公司人力资源部等部门审核,并经相关主体审核符合入住条件后确定。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议范本的主要内容如下(协议内容以公司根据相关主体的要求签订的最终协议为准):

出租方(甲方):苏州工业园区菁英公寓管理有限公司

承租方(乙方):苏州博创员工

担保方(丙方):苏州博创

管理方(丁方):苏州工业园区公租房管理有限公司

1、丙方向甲、丁双方承诺,若乙方年审合格的,乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲、丁双方签订《续租协议》,在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政策调整延长的,续租手续比照上述流程和原则执行。

2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。

3、在本合同存续期间,甲、乙、丁三方同意小区、户型变更、租赁续期等的,无需再次征得丙方同意,在本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。

4、乙方向甲方申请租赁优租房,经丁方资格审核通过后甲、乙、丙、丁四方共同签署《菁英公寓房屋租赁合同》。

四、担保的原因及必要性

苏州博创为员工公租房提供担保,有利于帮助员工减轻生活压力,建立对公司的归属感,促进其更好的为公司作出贡献,有利于提升公司经营管理效率,实现可持续发展。

公司将通过相关部门对被担保方的资信情况进行严格审查和评估,通过动态监控提供担保的员工情况,保证所有此类担保合计即期余额在董事会授权有效期内不超过人民币 200 万元。同时,公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况,避免违约产生。本次担保不会损害公司及股东利益。

五、相关审议程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。根据相关法律规定,本议案无需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,除本次提供的担保额度外,公司及子公司对外担保总额为 11,051.99 万元,为公司对子公司的担保及子公司对子公司员工租房的担保,分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 3.34%和 4.05%。截至本公告披露日,公司无逾期对外担保或发生涉及诉讼的担保的情况。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:688508　证券简称:芯朋微　公告编号:2026-019

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于 2026 年 3 月 12 日以现场方式召开。公司应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025 年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于(2025 年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于(2025 年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于(2026 年度财务预算报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于(2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于(2025 年度利润分配预案)的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成 7 票,